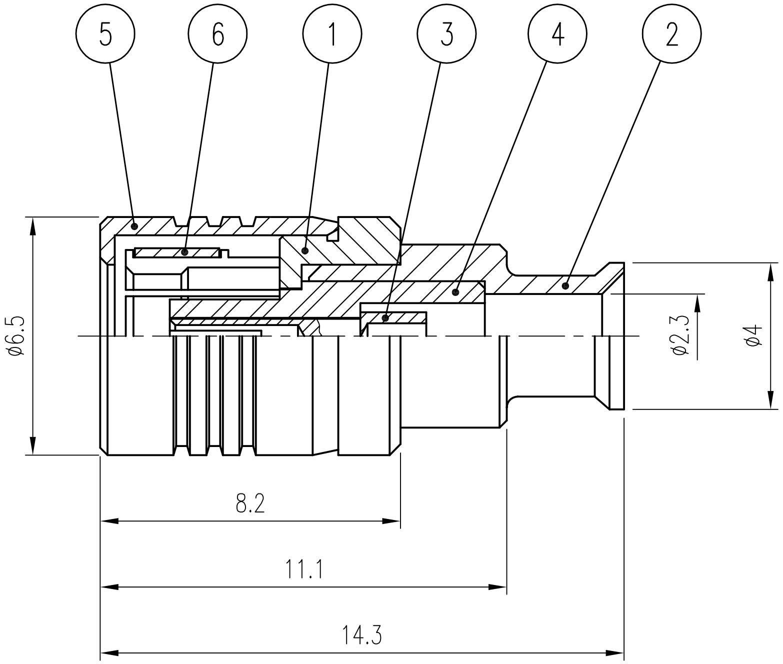
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	조립난이에 의한 설계변경	최충락	김기영	2000. 8. 4.



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-N45/1 (R3001) DSR00004-5/2 (R3001)
5	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00021-135/1 (K3001)
4	INSULTOR	1	TEFLON		DIN00346-N/1 (H3001)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00348-1345/1 (E3001)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00487-135/1 (D3008)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00433-135/1 (D3001)

대체가능재질

공통공차

.*	±0.1
.**	±0.05

재질 ________

열처리 ________

보호피막처리 ________

년월일	1994. 9. 1.
승인	
검도	
제도	
작성부서	연 구 소
척도 5/1	단위 mm, 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명: SMB-J-085

A4

도번: CN00181-7/1

K315-092-000